

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**Гнезда для печатной платы – однопарный Ethernet**

Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.

Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.

Преимущества однопарного Ethernet

- Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
- Готовность к будущему: основная технология для Индустрии 4.0 и Интернета вещей
- Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
- Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, Вставка печатной платы M8, IP67, с корпусом, Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 180°, Количество полюсов: 2
Заказ №	2795110000
Тип	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Кол.	100 Шт.

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	14,5 мм	Глубина (дюймов)	0,571 inch
Высота	22,1 мм	Высота (в дюймах)	0,87 inch
Ширина	10,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,398 inch
Масса нетто	5,14 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Упаковка

Длина VPE	327 мм	VPE с	327 мм
Высота VPE	52 мм		

Системные характеристики

Вид защиты	IP67, с корпусом	Категория	T1-B
Категория эксплуатационных характеристик	T1-B	Количество полюсов	2
Монтаж на печатной плате	Соединение под пайку для поверхностного монтажа	Серия изделия	Промышленный Ethernet
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную	Угол вывода	180°
Циклы коммутации	≥ 100		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 63171-5
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Номинальное напряжение	72 V	Номинальный ток	4 A
Прочность изоляции	≥ 500 MΩ		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Прочность изоляции	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал контакта	Сплав меди	Поверхность контакта	Ni/Au
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

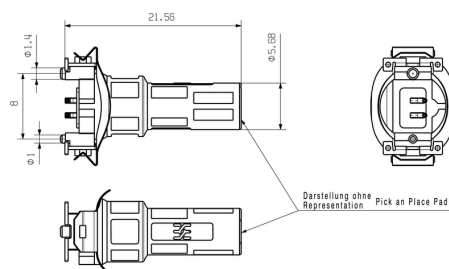
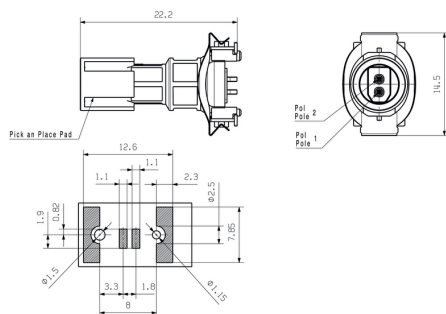
Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Техническая документация	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.